

とうきょうこうしゃ

ひらがなで記入。法人格(かぶ)等は不要。

技術分野

※1  
参照

# 株式会社東京公社

※2  
参照

IoT・AI

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 当社がアピールする技術キーワード | センサ、制御、信号処理、画像解析                                |
| 主要事業（メイン事業）      | AI を利用したデータ処理・システム開発・プリント基板設計製造                 |
| 取引のある市場分野        | ***業界、***分野                                     |
| 協力企業数、エリア        | *社、***エリア                                       |
| 規格・認証、従業員資格等     | ISO*****取得（2005 年）、*****の特許取得、***ビジネスプランコンテスト優勝 |
| 参入したい市場分野        | ***分野                                           |
| 主要設備、生産能力        | ***、***                                         |

## 大手企業等へアピールする技術キーワード詳細

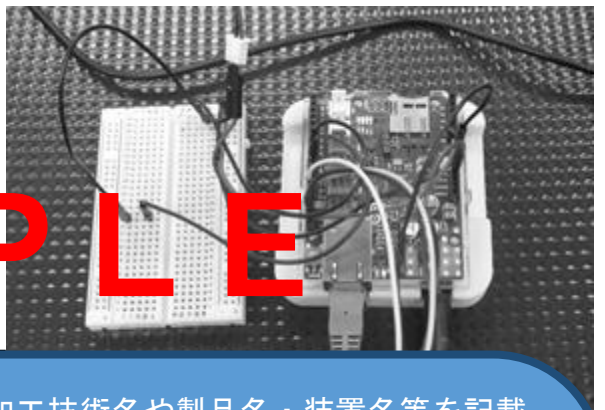
1. \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

2. \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SAMPLE



3.

・主要事業（メイン事業）については、具体的な加工技術名や製品名・装置名等を記載してください。

・大手企業等へアピールする技術キーワード詳細については、「特徴」や「優位性」等を「具体的」に記載してください。

（例）難加工材●●●を公差▲▲μmの精度で加工できる

●●の分野で蓄積した■◆技術をもとに、自社製品を開発した

●●産業におけるTier2企業である

少ないデータで、■■■の故障予兆AIモデルを作成することができる

●●を利用したIoTデバイスの受託開発実績がある

・専門用語には解説をつけてください。適宜、写真を加えてください。

・全体的な体裁を整える為、公社で微修正を入れることができます。予めご了承ください。

・記載いただいた技術アピールシートは外部に公開いたします。（※3）

[本社] 〒196-0033 東京都昭島市東町 3-6-1

[都内所在地] 同上

[工場] 同上

上段に本社（都外も可）、中段に都内所在地、  
下段に工場をご記入ください。

資本金：1,000 万円

従業員数：200 名

設立年（西暦）：2023 年

Web サイト：<http://www.tokyo-kosha.or.jp>

写真やイラストを用いて、**A4用紙 1 枚**で作成してください。

## ※1 「技術分野」は 7 つの選択肢（プルダウン）からお選び下さい

◆選択していただいた「技術分野」は、以下の2点で活用いたします。

- ①大手企業への配布資料として、技術分野ごとにまとめて掲載
- ②交流会の製品展示会で技術分野ごとに「ゾーン」を作ってブースを配置

## ※2 「当社がアピールする技術キーワード」は、当社がアピールしたい技術、製品、サービス等をご入力ください

◆入力いただいたキーワードの中から、当社が選定して HP やチラシ等に使用することがございますので、予めご了承ください。

### ※1 技術分野

### ※2 当社がアピールする技術キーワードの例

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 加工          | 金属・セラミック・ステンレス・樹脂加工／切断・プレス／精密板金／表面処理／めっき／難削材加工／加工一括受諾／微細加工等 |
| 電気・電子・光学    | センサー／電気・機構設計／光学設計／各種設計・制作／基盤設計／設計変更による軽量化等                  |
| システム・ソフトウェア | 画像解析／通信／音声認識・解析／測位等                                         |
| 評価・検査       | 非破壊検査／画像検査／材料分析／微小計測・測定／安心安全等                               |
| 材料          | 機能性樹脂／放熱・伝熱・断熱材料／稀少材料関連／光学材料／材料変更による軽量化等                    |
| IoT・AI      | 音声・画像認識／RPA／AR・VR／データ分析等                                    |
| その他         | その他                                                         |

## ※3 提出いただいた技術アピールシートは大手企業等へ限定公開します

技術アピールシートは、新技術創出交流会に参加する大手企業等へ限定公開いたします。

通年に渡り、大手企業等へ広くアピールいただくチャンスが広がります！